

FORMULARZ CENOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa zestawów komputerowych do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach				
L.p	Nazwa towaru	Opis	jednostka miary	Ilość zakupu
1.	Płyta główna	Obsługiwane rodziny procesorów Intel Core i9 Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Celeron Intel Pentium Gniazdo procesora Socket 1700 Chipset Intel H610 Typ obsługiwanej pamięci DDR5-5600 MHz DDR5-5200 MHz DDR5-4800 MHz DDR5-4400 MHz Liczba banków pamięci 2 x DIMM Maksymalna wielkość pamięci RAM 64 GB Architektura pamięci Dual-channel Wewnętrzne złącza SATA III (6 Gb/s) - 4 szt. M.2 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. Złącze RGB 4 pin - 1 szt. Front Panel Audio Złącze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt. Złącze wentylatora SYS/CHA - 2 szt. Złącze zasilania 8 pin - 1 szt. Złącze zasilania 24 pin - 1 szt. Złącze modułu TPM - 1 szt. Zewnętrzne złącza VGA (D-Sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ45 (LAN) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB 2.0 - 4 szt. PS/2 - 2 szt. Audio jack - 3 szt. Układ audio Realtek HD audio	szt	17
		Typ gniazdaSocket 1700 Liczba rdzeni10 rdzeni Liczba wątków16 Częstotliwość taktowania procesora3.7 GHz Częstotliwość maksymalna Turbo4.9 GHz Zintegrowany układ graficznyIntel UHD Graphics 770 Odblokowany mnożnikTak Wynik Benchmark27792 Architektura64 bit Proces technologiczny10 nm Mikroarchitektura procesoraAlder Lake-S TDP125 W PAMIĘĆ Rodzaje obsługiwanej pamięciDDR5-4800 Pamięć podręczna L110 x 32 KB (D),10 x 32 KB (I) Pamięć podręczna L28.5 MB Pamięć podręczna L320 MB	szt	17
3	Chłodzenie procesora	Sposób montażuWertykalny (Pionowy) Element kolorystycznyCzarny FIZYCZNE Wysokość [mm]146 Szerokość [mm]125 Głębokość [mm]65 Waga [g]435 TECHNICZNE Socket procesora1150/1151/1155/1156/1200,1700/1851,AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1,AM4,AM5 M5 Maksymalne TDP160 W Materiał podstawyAluminium + Miedź PodświetlenieNie CIEPŁOWODY Ilość ciepłowodów2 Średnica ciepłowodów6 mm WENTYLATOR Ilość wentylatorów1 Średnica wentylatora120 mm	szt	17

4	Zasilacz	Standard/FormatATX 3.1 Moc 500W Certyfikat sprawności80 Plus Bronze Układ PFCAktywne Sprawność89% Typ chłodzeniaAktywne - wentylator Średnica wentylatora120 mm ZabezpieczeniaOCP,OPP,OTP,OPP,SCP,SIP,UPP Modułarne okablowanieNie ZŁĄCZA ATX 24-pin (20+4)1 PCI-E 8-pin (6+2)2 PCI-E 16-pin (12+4)1 PCI-E 8-pinNie PCI-E 6-pinNie CPU 8-pin (4+4)1 CPU 8-pinNie CPU 4-pin1 SATA5 Molex1 INFORMACJE FIZYCZNE Wysokość [mm]86 Szerokość [mm]150 Głębokość [mm]140 PodświetlenieNie	szt	17
5	Dysk twardy	PARAMETRY FIZYCZNE Format dyskuM.2 2280 Grubość2.45 mm RadiatorNie PARAMETRY TECHNICZNE Pojemność dysku1 TB InterfejsPCI-E x4 Gen4 NVMe Pamięć podręcznaBrak danych Rodzaj kości pamięciBrak danych Szybkość odczytu7000 MB/s Szybkość zapisu6000 MB/s Odczyt losowy800000 IOPS Zapis losowy600000 IOPS Nominalny czas pracy1.5 mln godzin TBW (Total Bytes Written)600 TB KluczM Szyfrowanie sprzętoweNie	szt	17
6	Zestaw kości RAM 16GB	Typ złączaUDIMM Typ pamięciDDR5 ChłodzenieRadiator Pojemność łączna16 GB Liczba modułów1 Częstotliwość pracy [MHz]5600 Technologia podkręcaniaAMD EXPO,Intel XMP 3.0 FIZYCZNE PodświetlenieNie	szt	17
7	Obudowa	Obudowa typu Tower ATX z 1 wentylatorem Boki obudowy stalowe (bez okna)	szt	17
UWAGI: pkt 6 Kości RAM - Dopuszczalne w konfiguracji (2 kości 2*8GB) Proponowana cena powinna zawierać dostawę wraz z wniesieniem we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Ponadto minimalny okres gwarancji na ww. części to 24 miesiące <u>Części komputerowe powinny złożone w gotowe zestawy</u> Wszystkie części muszą być ze sobą kompatybilne i zgodne aby złożony z nich zestaw działał prawidłowo.				

Miejscowość i data

podpis i pieczęć wykonawcy
.....